

主要特点

- IC控制电路与LED点光源共用一个电源。
- 控制电路与RGB芯片集成在一个2121封装的元器件中，构成一个完整的外控像素点。
- 内置信号整形电路，任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出，保证线路波形畸变不会累加。
- 每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示，完成16777216种颜色的全真色彩显示；
- 内置上电复位和掉电复位电路。
- 端口扫描频率2KHz/s。
- 串行级联接口，能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
- 断点续传，额外增加一路信号线，实现双路信号传输，在单个像素点损坏的情况下，不影响整体显示效果；
- 任意两点传输距离在不超过2米时无需增加任何电路。
- 当刷新速率30帧/秒时，级联数不小于1024点。
- 数据发送速度可达800Kbps。
- 智能反接保护，5V电源接反时不会损坏元器件；
- 外围不需要包含电容在内的所有任何电子元器件。

主要应用领域

- LED像素屏、广告屏、异形屏，各种消费性电子产品。

产品概述

WS2813C-2121是一个集控制电路与发光芯片于一体的智能外控LED光源。其外型与一个2121LED灯珠相同，每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路，防反接电路，还包含有高精度的内部振荡器和高精度恒流控制模块，有效保证了像素点光的颜色高度一致。

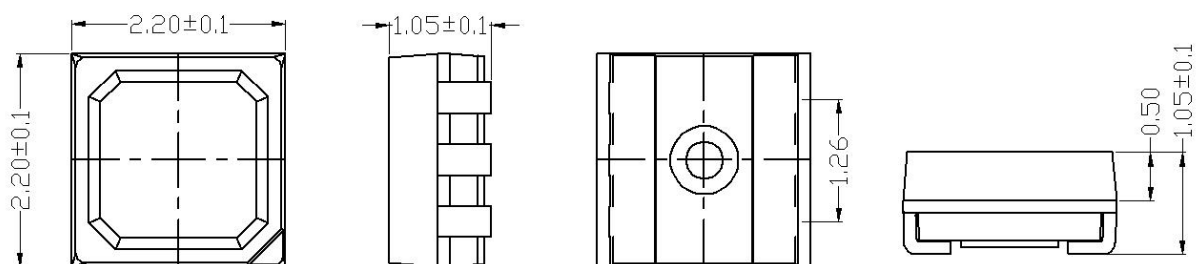
实现**双路信号传输**，在单个像素点损坏的情况下，不影响整体色彩的显示。

数据协议采用单线归零码的通讯方式，像素点在上电复位以后，DIN端接受从控制器传输过来的数据，首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后，送到像素点内部的数据锁存器，剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点，每经过一个像素点的传输，信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术，使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制，仅仅受限信号传输速度要求。

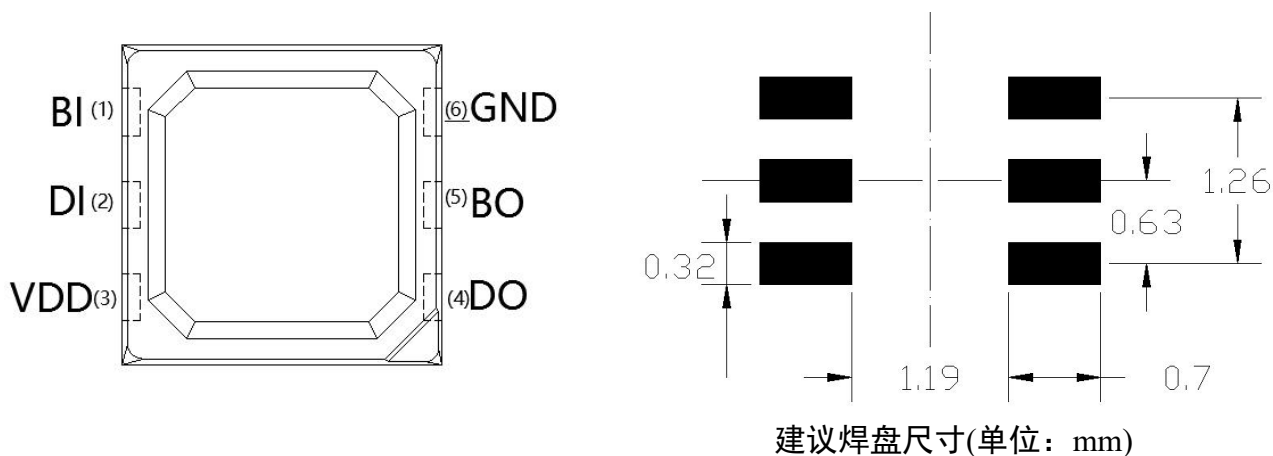
高达 **2KHz** 的端口扫描频率，在高清摄像头的捕捉下都不会出现闪烁现象，非常适合高速移动产品的使用。

280μs以上的 **RESET** 时间，出现中断也不会引起误复位，可以支持更低频率,价格便宜的MCU。

机械尺寸（单位mm）



引出端排列



引脚功能

| 脚位号 | 符号 | 管脚名 | 功能描述 |
|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | BI | 辅助信号输入 | 辅助信号输入引脚 |
| 2 | DI | 主路信号输入 | 主路信号输入引脚 |
| 3 | VDD | 电源 | 供电引脚 |
| 4 | DO | 主路信号输出 | 控制信号输出引脚 |
| 5 | BO | 辅助信号输出 | 辅助信号输出引脚 |
| 6 | GND | 地 | 信号接地和电源接地引脚 |

最大额定值

| 参数 | 符号 | 范围 | 单位 |
|--------|----------|---------------|----|
| 电源电压 | V_{DD} | +3.7~+5.3 | V |
| 逻辑输入电压 | V_I | -0.3V~VDD+0.7 | V |

电气参数 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=5\text{V}$, $V_{SS}=0\text{V}$)

| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
|--------|-----------|--------|----|----------|---------------|---------------------|
| 端口输出电流 | I_{out} | — | 20 | — | mA | OUTR+OUTG+OUTB |
| 输入电流 | I_I | — | — | ± 1 | μA | $V_I=V_{DD}/V_{SS}$ |
| 高电平输入 | V_{IH} | 0.7VDD | — | VDD+0.7V | V | D_{IN} |
| 低电平输入 | V_{IL} | -0.3V | — | 0.7V | V | D_{IN} |

开关特性 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=5\text{V}$, $V_{SS}=0\text{V}$)

| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
|--------|-----------|----|----|-----|---------------|---|
| 传输延迟时间 | t_{PLZ} | — | — | 300 | ns | $CL=15\text{pF}$, $DIN \rightarrow DOUT$, $RL=10\text{K}\Omega$ |
| 下降时间 | t_{THZ} | — | — | 120 | μs | $CL=300\text{pF}$, $OUTR/OUTG/OUTB$ |
| 输入电容 | C_I | — | — | 15 | pF | — |

LED 特性参数

| 参数 | 符号 | 颜色 | 静态电流: $<0.6\text{mA}$ | | | 单位 |
|------|-------------|-------|-----------------------|-----|-----|-----|
| | | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
| 发光强度 | IV | Red | 120 | 170 | 230 | mcd |
| | | Green | 300 | 420 | 600 | |
| | | Blue | 30 | 40 | 60 | |
| 波长 | λ_d | Red | 620 | | 625 | nm |
| | | Green | 522 | | 527 | |
| | | Blue | 467 | | 472 | |

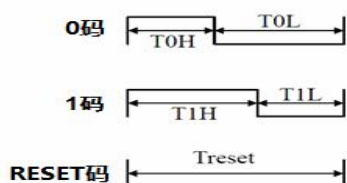
数据传输时间

| 符号 | 参数描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-----|------------|-----|-----|------|---------------|
| T0H | 0 码, 高电平时间 | 220 | 340 | 380 | ns |
| T1H | 1 码, 高电平时间 | 580 | 680 | 1000 | ns |
| T0L | 0 码, 低电平时间 | 580 | | 1000 | ns |
| T1L | 1 码, 低电平时间 | 580 | | 1000 | ns |
| RES | 帧单位, 低电平时间 | 280 | - | - | μs |

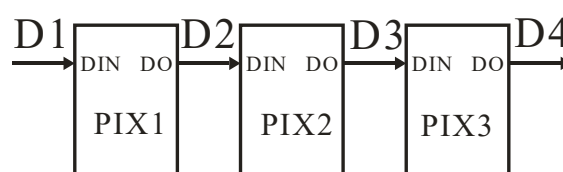
数据周期: $T0H+T0L \geq 1.25\mu\text{s}$; $T1H+T1L \geq 1.25\mu\text{s}$

时序波形图

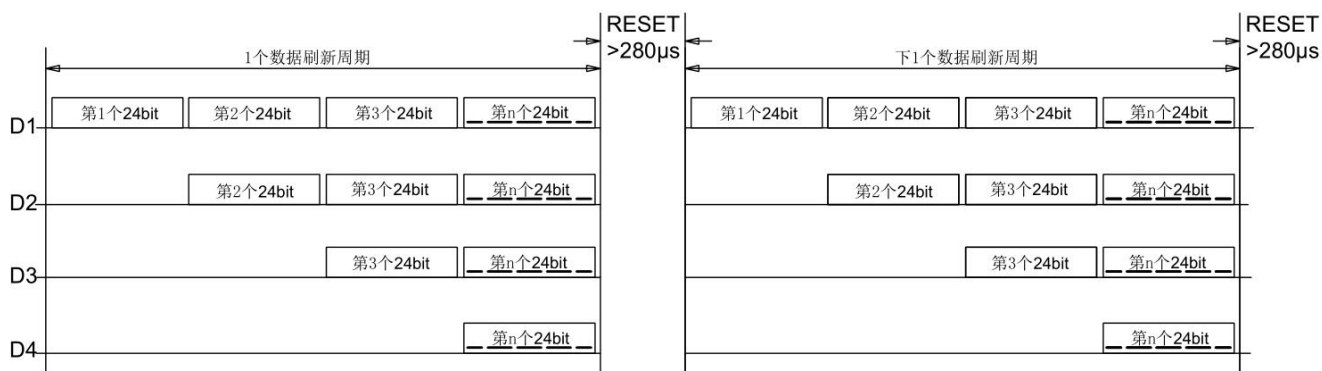
输入码型:



连接方法:

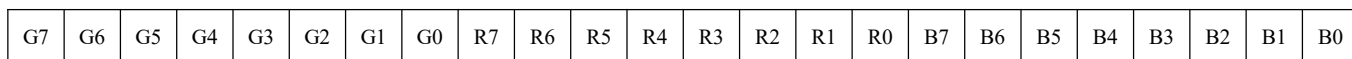


数据传输方法



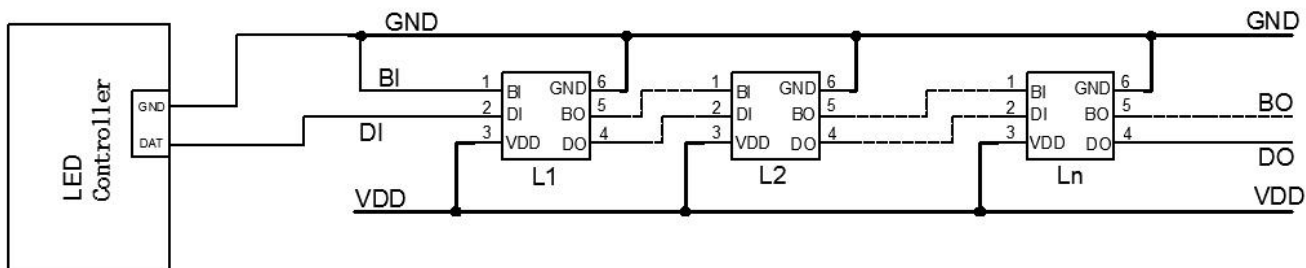
注：其中 D1 为 MCU 端发送的数据，D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据。

24bit 数据结构



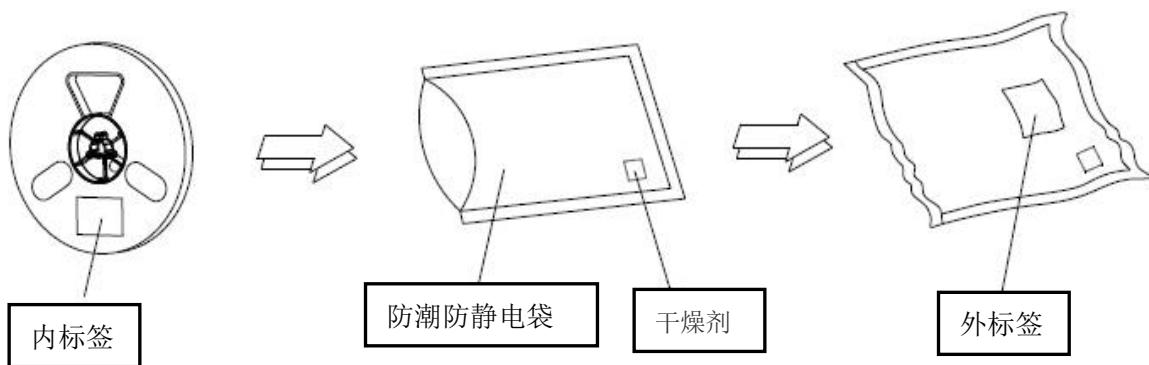
注：高位先发，按照 GRB 的顺序发送数据。

典型应用电路：第一颗 LED BI 接 GND

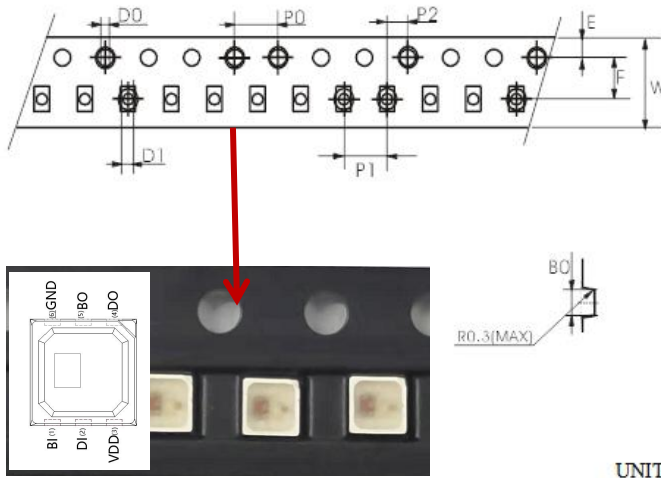


PCBA 设计时可以将 DI 和 BO 连通。

包装方式及数量 4000PCS /袋



载带规格及 LED 编带位置

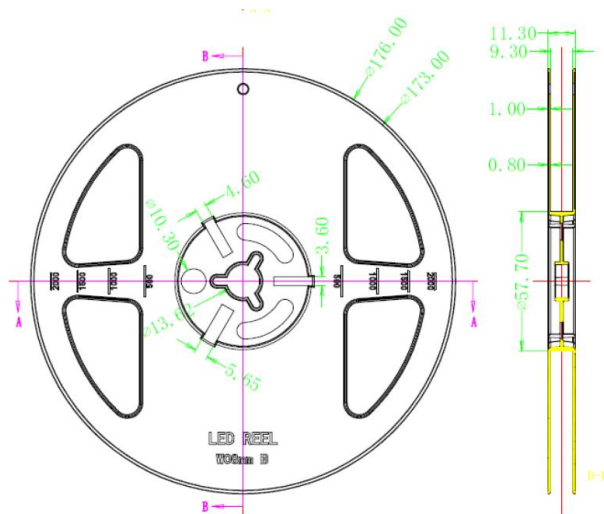


UNIT:MM

| SYMBOL | SPEC |
|--------|-----------|
| | 35±0.1 |
| B0 | 2.35±0.1 |
| | ±5±0.1 |
| P0 | 4.00±0.1 |
| P1 | 4.00±0.1 |
| P2 | 2.00±0.1 |
| T | 0.18±0.1 |
| E | 1.75±0.1 |
| F | 3.50±0.1 |
| D0 | 1.50±0.1 |
| D1 | 1.00±0.1 |
| W | 8.00±0.1 |
| 10P0 | 40.00±0.2 |

卷轴尺寸

单位: mm



表面贴装型 LED 使用注意事项

1. 描述:

通常 LED 也像其它的电子元件一样有着相同的使用方法, 为了让客户更好地使用华彩威的 LED 产品, 请参看下面的 LED 保护预防措施。

2. 注意事项:

2.1. 灰尘与清洁

LED 的表面是采用改性环氧胶封装的, 环氧胶对于 LED 的光学系统和抗老化性能都起到很好的保护作用。环氧胶易粘灰尘, 保持作业环境的洁净。当 LED 表面有一定限度内的尘埃, 也不会影响到发光亮度, 但我们仍应避免尘埃落到 LED 表面。打开包装袋的就优先使用, 安装过 LED 的组件应存放在干净的容器中, 在 LED 表面需要清洁时, 如果使用三氯乙烯或者丙酮等溶液会出现使 LED 表面溶解等现象, 不可使用具有溶解性的溶液清洁 LED, 可使用一此异丙基的溶液, 在使用任何清洁溶液之前都应确认是否会对 LED 有溶解作用; 请不要用超声波的方法清洁 LED, 如果产品必须使用超声波, 那么就要评估影响 LED 的一些参数, 如超声波功率, 烘烤的时间和装配的条件等, 在清洁之前必须试运行, 确认是否会影响 LED。

2.2. 防潮处理

LED 属于湿敏元件, 将 LED 包装在铝膜的袋中是为了避免 LED 在运输和储存时吸收湿气, 在包装袋中放有干燥剂, 以吸收湿气。如果 LED 吸收了水气, 那么在 LED 过回流焊时, 水气就会蒸发而膨胀, 有可能使胶体与支架脱离以及损害 LED 的光学系统。由于这个原因, 防湿包装是为了使包装袋内避免有湿气, 但通常保护时间仅能维持 1~2 个月。此款产品防潮等级 (MSL) 为: **5a**。SMT 时请参照 IPC/JEDECJ-STD-020 规定的材料防潮等级 (MSL) 定义进行 MSL 管控。

| 防潮等级 | 包装拆封后车间寿命 | |
|----------------|--------------|--------------------|
| | 时间 | 条件 |
| LEVEL1 | 无限制 | ≤30°C/85%RH |
| LEVEL2 | 1 年 | ≤30°C/60%RH |
| LEVEL2a | 4 周 | ≤30°C/60%RH |
| LEVEL3 | 168 小时 | ≤30°C/60%RH |
| LEVEL4 | 72 小时 | ≤30°C/60%RH |
| LEVEL5 | 48 小时 | ≤30°C/60%RH |
| LEVEL5a | 24 小时 | ≤30°C/60%RH |
| LEVEL6 | 取出即用 | ≤30°C/60%RH |

2.3 SMT 贴片要求:

2.3.1 建议 LED 在 SMT 前拆袋，整卷放入烤箱中进行除湿干燥（70~75℃烘烤 \geq 24H）；

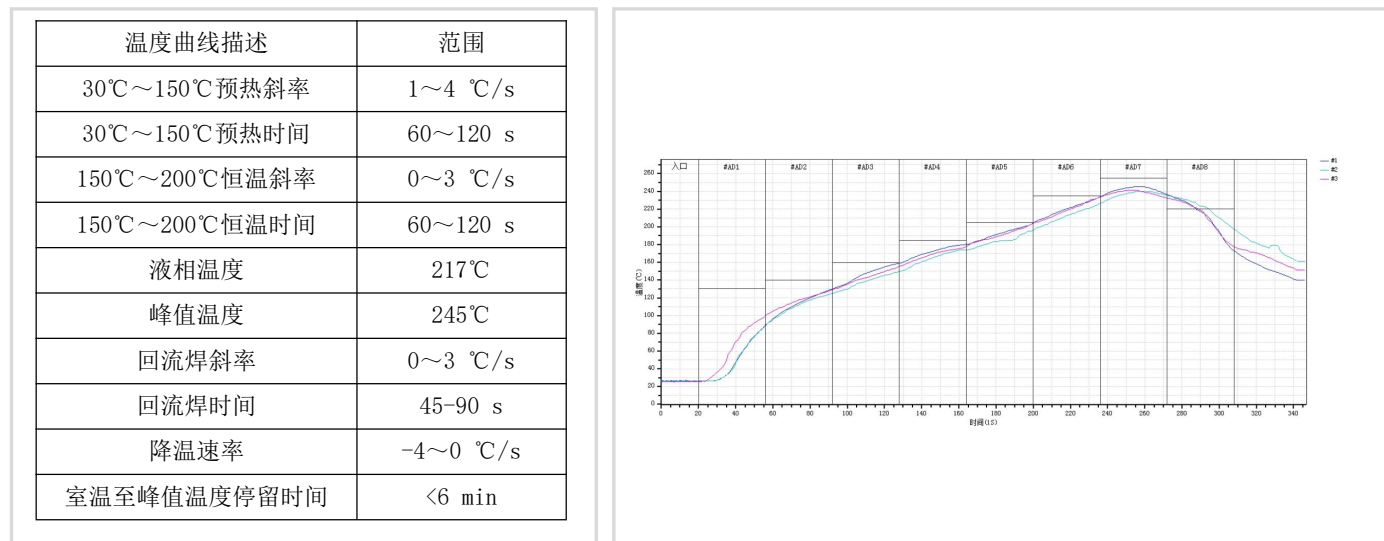
2.3.2 产品从烤箱中取出至高温焊接完成（包含多次回流焊、浸锡、波峰焊、加热维修等高温操作/作业），时间段控制在 24 内（在 T<30℃，RH<60%条件下）；

2.3.3 LED 贴片在印刷锡膏后的 PCBA 上，应尽快完成 SMT，建议不超过 1H；

2.3.4 生产剩余、机台抛料、维修用料等散料 LED，若长时间暴露在空气中，不可直接使用，建议进行除湿干燥后再被使用。整卷烘烤：70~75℃* \geq 24H 或 散料烘烤：120℃*4H。

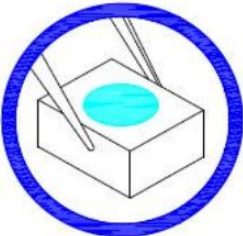

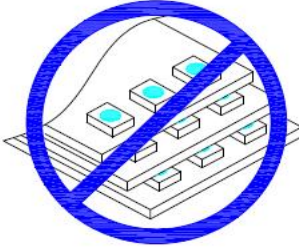

3. 焊接

表贴应用 LED 应符合 JEDECJ-STD-020C 标准，作为一般指导原则，建议遵循所用焊锡膏制造商推荐的焊接温度曲线，或使用我司如下推荐的焊接温度曲线。



注：以上所有温度是指在封装本体焊点表面测得的温度。

4. 产品装配过程注意事项

| | | | |
|---|---|--|---|
| 1. 通过使用适当的工具从材料侧面夹取 | 2. 不可直接用手或尖锐金属压胶体表面，它可能会损坏内部电路 | 3. 不可将模组材料堆积在一起，它可能会损坏内部电路 | 4. 不可用在 PH<7 的酸性场所 |
|  |  |  |  |

文件更改记录

| 版本号 | 状态 | 修改内容概要 | 修订日期 | 修订人 | 批准人 |
|------|----|--------|----------|-----|-----|
| V1.0 | N | 新建 | 20200501 | 沈金国 | 尹华平 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |